

案例介绍-某半导体制造企业Fab网络集成项目

该项目占地约700亩，总投资100亿美元，新建一条工艺等级90-65纳米、月产能约4万片的12英寸特色工艺集成电路生产线。本项目主要是对新建厂区的OA，FAB及中心机房的网络进行设计，规划和实施，并确保网络建设按时甚至提前达到要求的质量水平。

总体目标

- 1: 设计新厂整体网络架构，包括生产FAB区，办公自动化OA区，中心机房Server Farm区和其他功能区
- 2: 对整体网络需求进行规划，保证各区域之间的网络通信和安全
- 3: 施工过程中和其他各部门及其人员密切配合，在安全施工的前提下，保质保量完成项目内容
- 4: 项目完成后的知识转移和系统培训

项目特点



专业的团队：此项目中所有人员均有半导体行业中网络实施项目经验（至少一年），并保证从项目经理至网络工程师均达到CCNP以上工作能力。



实施工期紧：国家战略布局和世事局势，要求整个项目进度在保质保量的前提下必须按时甚至提前完成。对项目质量和项目把控提出了较高要求。



团队配合密切：现场环境存在交叉施工的情况。在保证安全施工的要求下，不仅要求团队内各人员分工有序还需要保证团队外沟通及时，密切配合。

案例介绍-某半导体制造企业Fab网络集成项目

设备类型及数量

型号	描述	数量
S12508X-AF	H3C S12508X-AF-以太网交换机主机	4
S12504X-AF	H3C S12504X-AF-以太网交换机主机	2
S6520X-26C-SI	H3C S6520X-26C-SI L3以太网交换机主机,支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,支持1个Slot	2
S6520X-54QC-EI	H3C S6520X-54QC-EI L3以太网交换机主机(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot)	8
S6520X-30QC-HI	H3C S6520X-30QC-HI L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot)	8
S6520X-54QC-HI	H3C S6520X-54QC-HI L3以太网交换机主机(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot)	1
S5560X-54F-EI	H3C S5560X-54F-EI L3以太网交换机主机,支持48*100/1000 Base-X SFP端口,支持4*10G Base-X SFP+端口,支持1个Slot	2
S5560X-30F-EI	H3C S5560X-30F-EI L3以太网交换机主机(24SFP(8GE Combo)+4SFP Plus+1Slot)	2
S5560-56C-HI	H3C S5560-56C-HI L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽	45
S5130S-52S-HI	H3C S5130S-52S-HI 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口	112
S5130S-52S-PWR-HI	H3C S5130S-52S-PWR-HI 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口(支持PoE+),支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口	38
SecPath F1070	H3C SecPath F1070 防火墙主机,16个10/100/1000BASE-T端口,8个100/1000 BASE-X SFP端口,2个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个Slots	8
SecPath F1050	H3C SecPath F1050 防火墙主机,16个10/100/1000BASE-T端口,8个100/1000 BASE-X SFP端口,2个Slots	2
WX3508H	H3C WX3508H 8端口千兆(2 SFP Combo)无线控制器	2
WA5530-SI-FIT	H3C WA5530-SI 内置天线三频六流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT	64